Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz

Ihr Ansprechpartner
Jens Jungmann

Durchwahl
Telefon +49 351 564 80600
Telefax +49 351 564 80680

presse@smwa.sachsen.de*

29.02.2024

Hightech aus Sachsen: Fast 1,8 Milliarden Euro für energieeffiziente Chips, modernste Sensoren und neue Materialien

Neun Innovationsprojekte im »Silicon Saxony« starten – Wirtschaftsminister Martin Dulig: »Sachsens Halbleiter-Schmieden stehen in der ersten Reihe europäischer Innovatoren.«

Die Entwicklung der Chiptechnologie in und um Dresden erhält den nächsten Innovations-Schub. Im Rahmen eines »wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse« (IPCEI) sollen auch neun sächsische Projekte für technologischen Vorsprung der europäischen Mikroelektronik- und Kommunikationstechnikindustrie sorgen. Das gesamte Projektvolumen einschließlich der Fördermittel beläuft sich auf 1,79 Milliarden Euro.

Nach den Förderzusagen von Bund und Land in Höhe von insgesamt 795 Millionen Euro stehen die in eine gesamteuropäische Innovationsagenda eingebetteten sächsischen Vorhaben in den Startlöchern und führen jeweils Auftaktveranstaltungen durch. Heute startet mit »Eurofoundry« das größte Teilprojekt in die Umsetzungsphase. Bei GlobalFoundries im Dresdner Norden kommen die Experten des Unternehmens mit Vertretern von Bund und Land zu einem Arbeitstreffen zusammen, um das große Forschungs- und Entwicklungsvorhaben anzuschieben.

Dazu sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig: »Sachsens Halbleiter-Schmieden stehen in der ersten Reihe europäischer Innovatoren. Mit Unterstützung durch Bund und Land werden in und um Dresden in den kommenden Jahren bahnbrechende Neuheiten für das autonome Fahren, intelligente Medizintechnik, energieeffiziente Steuerelektronik und Künstliche Intelligenz entwickelt. Die Projekte zeigen zugleich, wie eng die am Standort aktiven Unternehmen vernetzt sind und gemeinsam an einer digitalen Zukunft arbeiten. Die technologische Unabhängigkeit von Asien und den USA werden wir nur erringen, wenn wir vor Ort in Europa produzieren und eigenständig sind.«

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

www.smwa.sachsen.de

Zu erreichen ab Bahnhof Dresden-Neustadt mit den Straßenbahnlinien 3 und 9, ab Dresden-Hauptbahnhof mit den Linien 3, 7 und 8. Haltestelle Carolaplatz.

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Die sächsische Staatsregierung hatte dazu am 13. Juni 2023 den Weg freigemacht und den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund gebilligt. Die Förderung von insgesamt gut 795 Millionen Euro wird zu 70 Prozent vom Bund und zu 30 Prozent vom Freistaat Sachsen getragen. Die europaweit abgestimmten Projekte haben eine Laufzeit bis zum Jahr 2027, im Einzelfall bis 2029. Am Standort Dresden finden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten folgender federführender Partner statt:

- **GlobalFoundries Dresden** will den Weg von der Idee zum fertigen Chip beschleunigen. Dafür soll eine neue Design-Umgebung entwickelt werden, um schneller maßgeschneiderte Chipdesigns für Industrie-4.0-Anwendungen, die Energiewirtschaft, autonomes elektrisches Fahren oder die Medizintechnik anbieten zu können.
- Die **BOSCH-Gruppe** ist mit drei sächsischen Standorten jeweils in Teilprojekten aktiv. Mit neuen Chipgenerationen, die intelligent miteinander und mit der Cloud kommunizieren, soll eine umweltfreundliche, hoch automatisierte und augmented-reality-fähige (AR) Systemarchitektur u.a. für die Automobilindustrie entstehen.
- Die **Ferroelectric Memory GmbH**, eine junge Ausgründung der TU Dresden, erforscht und entwickelt neuartige Speicherchipkonzepte auf der Grundlage einer neuen Klasse von Speicherzellen.
- Die **Freiberger Compound Materials GmbH** als führender Hersteller von Halbleiter-Materialen entwickelt Technologien, um die neuen Substrate Galliumarsenid, Indiumphosphid und Galliumnitrid auf Wafergrößen für die industrielle Fertigung zu skalieren.
- **Infineon Technologies Dresden** und die zum Konzernverbund gehörende **Siltectra GmbH** werden neue Materialien, Konzepte und Prozesse beispielsweise für Druck-, Umgebungs-, 3D-Sensoren und Mikrofone entwickeln, um die Verknüpfung der realen mit der digitalen Welt zu beschleunigen.
- Die **NXP Semiconductors Germany GmbH** mit Standorten in Hamburg, München und Dresden ist ein Spezialist für Automobil-, Telekommunikations- und Cybersicherheits-Chips mit Muttergesellschaft in den Niederlanden. Das NXP-Projekt fokussiert insbesondere auf leistungsfähige Radarsensoren und Mikroprozessoren für die weitgehend lokale Datenverarbeitung beim autonomen Fahren.

Hintergrund

»Important Projects of Common European Interest« (IPCEI) sind transnationale, wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse, die mittels staatlicher Förderung einen wichtigen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leisten.

Die Projekte wurden aufgrund eines Förderaufrufs durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 25. Januar 2021 ausgewählt und nach umfangreichen Prüfungen am 8. Juni 2023 von der EU-Kommission als zulässig anerkannt. Das BMWK hatte die Projekte auf einer Veranstaltung am 18. September 2023 öffentlich vorgestellt und inzwischen die jeweiligen Zuwendungsbescheide erlassen.

Links:

PM SMWA zur Verwaltungsvereinbarung, 13. Juni 2023: Bund und Land fördern Technologieprojekte im »Silicon Saxony« mit voraussichtlich rund 877 Millionen Euro

PM BMWK zum Termin am 18. September 2023: BMWK - Mikroelektronik für Deutschland und Europa: Hochrangiges Treffen von Politik und Branche im BMWK